武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月 21 日、2024年5月14日召开第四届董事会第三十五次会议、2023年度股东大 会,审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》,为保证公司及 下属各子公司的正常生产经营,拓宽资金渠道,公司或子公司拟对子公司 2024 年度向银行申请综合授信提供保证担保,担保总额不超过38.5亿元人民币;其 中,公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司(以下简称"上海精测")向 银行申请授信提供最高担保额度人民币 8.3 亿元,授信品种:流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最 终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于 2024 年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电 子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号: 2024-059) .

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规定, 具体担保进展情况披露如下:

二、担保进展情况

为满足子公司上海精测日常经营发展需要,公司近日与上海农村商业银行股

份有限公司上海长三角一体化示范区分行(以下简称"农商银行")签订编号为 "72275254100082"的《最高额保证合同》,约定公司为上海精测向农商银行于 保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司为上述子公司 提供担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

(一)《最高额保证合同》(编号: 72275254100082)

- 1、债权人: 上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
- 2、保证人: 武汉精测电子集团股份有限公司
- 3、债务人:上海精测半导体技术有限公司
- 4、保证额度有效期自 2025 年 4 月 11 日起至 2026 年 4 月 10 日
- 5、保证最高本金限额为人民币: 伍仟万元整
- 6、保证方式:连带责任保证
- 7、保证范围:主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等)以及为实现债权而发生的费用,包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
 - 8、保证期间: 主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日,公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司,担保方式为连带保证责任担保;公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为88,924.34万元(不含子公司对公司的担保),占公司截至2023年12月31日净资产的24%。公司及子公司无逾期对外担保事项,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年4月14日